# 证券代码：688693 证券简称：锴威特

**苏州锴威特半导体股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**（2025年半年度业绩说明会）**

编号：2025-002

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会  新闻发布会 路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） |
| **参与单位名称及人员姓名** | 线上参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2025年09月30日 15:00-16:00 |
| **地点** | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 丁国华 董事、总经理 罗寅 独立董事 秦舒 董事会秘书 严泓 财务总监 刘娟娟 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1.BLDC电机驱动领域已打入头部终端客户，后续在该领域还有哪些客户拓展计划？**  答:尊敬的投资者,您好！应用公司电机驱动IPM产品的BLDC通过大洋电机的认证并进入美的、海尔等头部终端客户。集成快恢复平面MOSFET（FRMOS）及SiC MOSFET凭借高可靠性、参数一致性优势，获众多芯片设计公司选用。打入头部终端客户后，公司正利用其标杆效应进行横向拓展，深化与现有客户的合作，适应电机功率逐步增加，从单一型号产品向全系列产品线拓展。重点开拓空调电机、工业控制、电动工具等领域的其他龙头厂商。目前，我们已经与多家目标客户进入了产品测试和方案评估阶段，进展符合预期。感谢您的关注！  **2.下半年公司在业务增长和盈利能力提升上有何目标？**  答:尊敬的投资者,您好！公司核心目标是实现高质量的成长。在业务上，力争保持营收的稳健增长势头；在盈利上，通过优化产品结构、提升运营效率、加强成本管控等多方面举措，努力改善净利润率水平。公司上下正全力以赴，为全年交出更好的答卷而努力。感谢您的关注！  **3.三季度营业收入能保持上涨吗？**  答:尊敬的投资者，您好！公司业绩情况需要根据规定在定期报告中披露，烦请您关注公司后续披露的定期报告内容。感谢您的关注！  **4.研发费用增长41.13%的主要投向是什么？**  答:尊敬的投资者,您好！增加的研发投入主要聚焦于稳步推进产品研发及迭代升级、持续推进关键技术攻关与产品平台建设，围绕中高功率密度电源和电机驱动系统需求的功率半导体芯片展开研究，立足为用户提供高性能的功率芯片的系统解决方案，持续完善和丰富产品谱系。感谢您的关注！  **5.报告提及“功率器件+功率IC”协同优势，能否举例说明这种协同在具体客户项目中的应用？**  答:尊敬的投资者,您好！在电机驱动领域：功率驱动IC与功率器件协同，使得在设计阶段就考虑的器件安全工作区、EMI和各类保护功能的完善，形成集成功率模块的性能和可靠性进一步提升，加快了第三代半导体SiC功率模块的研发与应用。在电源领域：功率驱动IC与功率器件协同，可以为客户提供完整的解决方案，缩短客户设计周期以及方便生命周期技术支持。以最常见的隔离反激电源为例，锴威特可以提供基于PWM控制器电源IC+外置功率MOSFET的5W~150W反激电源方案，广泛应用于工业辅助电源、各类适配器电源、伺服电机系统、光伏储能系统等。感谢您的关注！  **6.高可靠领域客户的认证流程和合作稳定性如何？公司如何维持该领域的准入壁垒？**  答:尊敬的投资者，您好！高可靠领域因其特殊的应用场景，对产品的质量与可靠性要求极高，客户端产品导入需要经过严格的验证流程和可靠性考核，因此产品导入周期长，需经过多轮技术评审、可靠性测试、现场审核和小批量验证。公司凭借持续的技术创新和品控体系，深厚的应用理解和服务能力，能为客户提供全生命周期的技术支持，确保产品的一致性和可靠性。感谢您的关注！  **7.平面MOSFET的“少子寿命控制技术”相比行业传统工艺的优势体现在？**  答:尊敬的投资者,您好！该技术是公司高压平面MOSFET产品的核心技术亮点，技术特点是通过控制重金属掺杂浓度，控制硅中的少子寿命，技术整体达国际先进水平。利用该技术制造的FRMOS产品具有反向恢复时间短、漏电流小、高温特性好、反向恢复特性较软、低电磁干扰的产品特性，性能优于利用电子辐照技术制造的同类产品。感谢您的关注！  **8.公司在新能源汽车相关领域的产品的认证进展和客户导入情况怎么样了？**  答:尊敬的投资者,您好！在工业及通讯电源领域，公司实现关键技术突破，将高可靠领域功率IC技术成功转化至工控应用，研发的功率因数校正PFC、大功率LLC拓扑谐振控制IC等多款产品进入全面试产，彰显技术转化能力与市场适配性，BMS用SGT MOS、控制IC已导入市场，移相全桥控制IC已完成AEC-Q100车规级认证，产品已通过部分终端客户验证。感谢您的关注！  **9.合并众享科技后，双方在技术整合的具体进展如何？**  答:尊敬的投资者,您好！自合并以来，整合效应正在逐步释放。技术上，双方研发团队已深度融合，技术实现了协同创新，共同开发了多款性能更优、性价比更高的产品。在市场端，我们实现了客户资源的共享与交叉销售，协同效应显著，达到了“1+1>2”的预期目标。感谢您的关注！ |
| **关于本次活动是否涉及应**  **披露重大信息的说明** | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2025年09月30日 |